

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-106

# 深圳市民德电子科技有限公司 2018 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄效东	董事	公务出差	许文焕

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	民德电子	股票代码	300656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范长征	何力衡	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层 (1) 号	深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层 (1) 号	
电话	0755-86329828	0755-86329828	
电子信箱	ir@mindeo.cn	ir@mindeo.cn	

### 2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	89,646,766.44	55,894,553.00	60.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,921,497.71	18,387,513.73	30.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,086,503.19	17,057,947.67	-17.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,866,491.43	4,257,614.09	-566.61%
基本每股收益（元/股）	0.2658	0.2581	2.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2658	0.2581	2.98%
加权平均净资产收益率	5.64%	8.73%	-3.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	591,390,490.34	447,733,210.10	32.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	427,822,602.98	419,249,865.66	2.04%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	5,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许香灿	境内自然人	14.39%	12,953,884	12,953,884		
许文焕	境内自然人	13.54%	12,185,160	10,538,760	质押	6,238,050
易仰卿	境内自然人	12.36%	11,121,036	8,340,777	质押	3,060,000
黄效东	境内自然人	9.30%	8,372,496	6,279,372	质押	1,845,000
福建新大陆电脑股份有限公司	境内非国有法人	7.43%	6,682,500	6,682,500		
黄强	境内自然人	6.22%	5,598,738	0		
罗源熊	境内自然人	4.95%	4,457,010	3,342,757	质押	2,200,000
邹山峰	境内自然人	3.34%	3,007,913	2,255,934	质押	735,000
蓝敏智	境内自然人	2.42%	2,181,073	0		
白楠	境内自然人	1.46%	1,317,367	988,025		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许香灿先生和许文焕先生系父子关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年上半年，中国GDP总量达到41.9万亿，同比增长6.8%，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换。实体经济层面，半导体产业链各环节加速发展，物联网产业得到进一步广泛应用，公司在利用自身优势稳固发展条码信息识别产业基础的同时，通过收购整合，成功进驻半导体产业，为公司长远发展迎来更广阔空间。

报告期内，公司实现总营业收入8,964.68万元，较上年同期增长60.39%；归属上市公司股东的净利润2,392.15万元，较上年同期增长30.10%。截止报告期末，公司总资产59,139.05万元，较上年末增长32.09%，归属上市公司股东的权益42,782.26万元，较上年末增长2.04%。2018年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要原因系本报告期公司暂时闲置资金购买银行理财产品收益较上年同期大幅增长，以及公司2018年6月完成重大资产重组项目交割程序后，将泰博迅睿公司合并日后的经营业绩纳入公司合并范围所致，同时公司报告期内重大资产重组产生的交易费用金额较大，研发投入的人员、材料及技术开发费用增加较多，导致管理费用增加较多，对净利润的增长产生一定的抵减效果。

#### 1、稳固发展条码识别业务

本报告期内，条码识别业务是公司的主要业务，且未来期间条码识别业务将一直作为公司的基础业务之一。本报告期内，公司条码识别业务的营业收入较上年同期下降11.68%，主要是由于随着条码技术的普及和扫码应用的推广，条码识别细分领域的竞争对手随之增加，市场竞争进一步加剧。公司坚持自主创新和品牌营销，保持在专用设备领域以及中高端商业应用领域的竞争优势，本报告期的毛利率保持在48.07%的较高水平，与上年同期基本一致；但同时，部分中低端商业应用领域的市场份额有所降低。基于目前的市场需求和产品竞争格局，公司顺应市场形势，积极调整产品开发策略，加大了对合作开发定制芯片和产品核心部件标准化水平的研发力度。基于目前的研发进度，定制芯片预计将在2019年第一季度投入试产，若能成功投产和应用于公司产品，预期将大幅提升产品性能、降低产品成本、适应产品小型化等定制化需求，增加产品市场竞争力，进而特别有助于提升公司在中低端商业应用领域的产品市场竞争力。此外，公司密切关注条码应用的市场需求和演变，及时推出适用于微信支付、扫码开票、交通扫码等新兴条码应用领域的产品，给客户便捷、新颖和个性化的服务。

#### 2、收购电子元器件分销业务，实质性推进半导体战略

2018年6月，公司通过收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入电子元器件分销行业，公司半导体产业战略得到实质性推进。后续，公司将以电子元器件分销业务为基础跳板，充分吸收半导体产业链上下游商业资源及精英人才资源，加深对半导体产业的认知与理解，并积极探寻半导体设计、原材料与设备供应链、制程等上下游产业链机遇。

在经营策略上，泰博迅睿公司主要采取差异化竞争策略，专注于服务各个新兴电子制造领域的创新型企业，主要客户包括深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“大疆创新”）、深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”）和深圳市世纪云芯科技有限公司（以下简称“世纪云芯”）等企业。该等客户在所属领域内均具有较强的创新能力和市场影响力，属于细分领域的龙头企业，如大疆创新是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，市场占有率居全球第一；欣锐科技系以新能源汽车产业为核心业务的国家高新技术企业，是国家科技部863项目和国家发改委战略性新兴产业项目的主承接单位；世纪云芯是主要从事高速、低功耗计算芯片，大功率、高密度计算服务器和大规模并行计算软件等超级计算芯片的研发、生产和销售业务的新兴高科技企业。经过长期市场开拓，泰博迅睿公司与该等客户均建立了稳定的合作关系。该等优质客户的快速发展带动了泰博迅睿公司业绩的迅速增长；与此同时，通过对该等行业内优质客户的服务，泰博迅睿公司进一步扩大了自身在上游原厂和下游市场的影响力。

在收购整合前，泰博迅睿公司以代理分销被动元器件为主，主要代理品牌为村田、松下、信昌、奇力新等；收购整合后，泰博迅睿公司纳入民德电子上市公司信用体系，得到公司资本、品牌和各项资源的有力支持，业务规模在短时间内得以迅速扩张，且代理分销产品类别也从被动元器件扩展至主动元器件，与美国硅谷GLF等品牌建立代理合作。2018年上半年，泰博迅睿公司实现营业收入9,345.49万元，实现净利润1,634.22万元，较其2017年全年营业收入10,471.38万元和净利润807.05万元，泰博迅睿公司2018年全年业绩有望实现较大幅度的增长。2018年6月5日，泰博迅睿公司完成工商变更登记，成为公司的全资子公司；本报告期内，泰博迅睿公司纳入合并范围内的营业收入和净利润分别为2,724.33万元和417.25万元。

#### 3、企业品牌建设和企业形象提升

报告期内，公司积极推进企业品牌建设和企业形象提升。2018年2月，公司通过复审，继续被认定为深圳知名品牌。截至报告期末，公司为国家高新技术企业和深圳市高新技术企业，中国中小企业协会评定公司为企业信用等级AAA级；公司拥有国内注册商标4项，国际注册商标10项，公司商标被授予广东省著名商标证书。

报告期内，公司坚持以科技创新为动力，高度重视研发工作并持续投入研发，在优化“产品项目组+模块”的矩阵式组织管理架构的基础上，积极提高研发效率和推动研发成果产品化，实现研发、生产与市场的良性互动衔接。报告期内，公司新

获发明专利2项、软件著作权登记2项，截至报告期末，公司拥有授权注册专利40项，其中：发明专利13项、实用新型专利14项，外观设计13项；软件著作权登记18项；集成电路布图设计权1项；专利合作协定（PCT）5项。

#### 4、公司半导体产业发展思路与规划

##### （1）公司选择战略拓展半导体产业的原因

自2017年5月上市以来，公司经营团队积极探索未来发展，多方探寻，仔细论证，并逐步确定了未来以半导体产业为核心的企业发展战略，主要原因如下：

①创始团队多年以来一直对半导体产业葆有浓厚情怀并紧密关注。公司创始团队成员长期深耕电子产业，深知半导体产业规模宏大，且作为基础支柱产业对国家整体电子产业发展至关重要。纵观美国、日本、韩国和台湾半导体产业发展及变迁历史，也均造就了一大批像三星电子、英特尔、台积电、东芝等这样尤为杰出的企业。公司创业阶段因资源有限，未能涉足半导体产业。上市以后，公司创始团队即积极探寻半导体产业机遇并充分论证可行性。

②得天时、地利、人和、政通，中国半导体产业乘势发展正当时。半导体产业发展与国家GDP增速呈极强的正相关性，正如半导体产业史过程中向经济增长的日本、韩国、台湾迁移一样，如今作为世界经济重要增长极的中国正迎来前所未有的半导体产业迁移浪潮，中国半导体全产业链迎来重大战略发展机遇，此为天时；伴随汽车电子、5G、物联网、AI等技术在终端应用的推广，中国已成为全球半导体产品最大的消费市场，此为地利；受中国半导体产业迁移的历史大背景感召，越来越多半导体国际大厂和产业链上下游企业纷纷在中国投产立足，带来并培育大量半导体人才，此外，诸多海外半导体精英人才也受影响纷纷回国发展，此为人和；为加速中国半导体产业的升级突破，中国政府出台一系列强有力的支持政策，并由国家及各地政府出面牵头成立数千亿级半导体产业投资基金，此为政通。得此天时、地利、人和、政通，中国半导体产业必将迎来发展黄金时期。

③战略拓展半导体产业将进一步打开公司未来成长空间。公司现主营条码识别业务全国市场容量不足百亿元人民币，而半导体产业全国市场容量超万亿元人民币，且仍保持较快增速。成功拓展进驻半导体产业，公司发展将驶向更为广阔的蓝海市场，为公司未来打开更为广阔的成长空间。

④公司具备一定的半导体产业链涉足经验基础。公司曾参与开发多款应用于条码识别设备的自研芯片，并成功应用于公司条码识别设备，大幅降低产品成本。过程中，公司全程参与自研芯片的设计与制程，对半导体产业链上下游均有涉猎和接触，积累了一定的半导体产业认知与行业资源。

##### （2）公司半导体产业拓展的初步思路

因半导体产业链上下游（原材料与设备、设计、制程、分销）产业环节多为资金密集型和技术密集型，公司原有团队半导体相关人才较为缺乏，自身开展半导体业务能力受限，因此，公司主要通过投资并购方式布局半导体产业。

鉴于公司初步正式涉足半导体产业，出于合理谨慎性的考量，公司选择从对于技术门槛要求相对不高的分销环节切入，并于2018年6月收购泰博迅睿公司。

泰博迅睿公司是一家处于快速成长期的半导体电子元器件分销企业，有着非常优质的上游原厂供应商资源和下游战略新兴市场细分领域龙头企业客户资源。泰博迅睿公司创始团队与公司创始团队有着高度认同的事业价值观，均有志于打造一家卓越的中国半导体平台型企业。通过收购整合，公司为泰博迅睿公司发展提供品牌、资金、资源支持，助力其经营规模和效益快速放大；另一方面，通过对泰博迅睿公司的收购整合，也使公司进一步加深对半导体产业的认知与理解，并且得以充分拥抱半导体产业链上下游丰富的产业机遇资源和精英人才资源，为公司在半导体产业进一步投资布局奠定基础，真正做到“谋定而后动”。

后续，公司将始终以半导体产业摩尔定律的发展效率作为自身参照要求，持续积极寻找半导体产业适宜投资并购机遇，探索灵活合作模式与商业模式，并在公司内部以及被投资标的之间建立长效激励机制，最大化实现公司资源投入产出效率。

以半导体设计业务为例，公司可能采用的合作与投资模式如下：利用公司现有的国内市场分销渠道资源，为半导体设计公司提供中国市场资源支持；在产品得到市场端初步验证的基础上，公司可酌情考虑以股权或债权方式为设计公司提供资金进行流片生产，并在设计公司达到一定经营业绩且双方一致认同的前提下，对设计公司进行完全或控股收购。

##### （3）公司未来半导体产业投资并购标的的筛选标准

公司未来将持续在半导体产业进行投资并购，公司目前对半导体产业投资并购标的的筛选的初步标准和考量如下：

①半导体产业细分蓝海型市场：须属于半导体产业中具有足够大市场规模且不断增长、在中国尚未形成产业垄断格局且中国企业有望实现进口替代的细分市场；

②精英体制团队：团队核心成员须为半导体产业细分领域精英人才，具有远大理想，团队人均产值效能高；

③具有高成长性：在得到关键资源和能力支持后，须在未来五年保持年均50%的业绩增长；

④具备良好的盈利能力或潜质：具有较高的产品毛利率、净利率、净资产收益率，或者在实现业务放量后有实现较高产品毛利率、净利率和净资产收益率的潜质。

##### （4）公司未来投资并购的机制设计考量

公司将把风险放在并购决策的核心位置，在投资并购机制设计环节即充分考量并购可能带来的大额商誉、并购标的业绩不及预期，以及并购整合失败等潜在的并购风险。通过设置严苛的并购标的的筛选标准，以及创新性的并购条款安排，公司使用并购机制的设计来实现并购标的的交易对方（即并购标的的核心创始团队）与上市公司股东利益深度绑定，通过机制设定驱动各方共同追求上市公司长期价值的增长，进而也实现交易对方个人价值的最大化。

具体而言，公司以提升整体净资产收益率为目标，在保持财务杠杆处在合理水平前提下，优先选择现金方式进行并购。同时，交易对方将使用其获得的现金对价（通常至少65%以上）从二级市场购买民德电子上市公司的股票，交易对方对前述股票予以长期锁定（通常至少不短于5年）并根据并购标的的实际业绩实现情况来分期解除锁定，进而实现并购标的的交易对方

与上市公司股东利益的长期深度绑定，避免常规并购项目中因业绩对赌期较短、并购标的交易对方出现追求短期利益而产生的道德风险。除此之外，交易对方还须对其被并购后中长期（通常十年内）的累计实现净利润做出承诺，原则上不得低于上市公司并购过程中支付的全部交易对价，这样将大大降低未来商誉减值风险对上市公司带来的不利影响。

未来，公司将继续坚定推进以半导体业务为核心的企业发展战略，以上市公司股东长期价值成长为目标，通过投资并购与并购标的核心创始团队共同构建一个事业型的合伙人平台，最终将公司打造为一家卓越的中国半导体产业平台型企业。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

报告期内，公司重大资产重组收购深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权，从而合并范围新增全资子公司及其下属公司共4家。

深圳市民德电子科技股份有限公司

法定代表人：许文焕

2018年8月30日